# 넥센서 nXI-2

## 대면적 백색광 간섭 변위 측정 센서

3D Solution

nXI-2는 정밀 측정장비의 검교정에 사용되는 기술인 간섭 측정법(Interferometry)이 적용된 제품으로 넓은 영역에 대해서 정밀한  측정이 가능한 제품입니다.

넓은 영역을 빠른 속도로 측정 가능해 양산 라인에 적용하기에도 매우 편리하며 기존의 간섭 측정법보다 10배 이상 빠른 속도로 측정하고 신뢰성 있는 데이터를 제공함으로써 공정 효율 향상과 생산 품질 개선을 제공합니다.

단차, 두께 측정이 가능한 제품으로 반도체의 구조, 범프 측정, 디스플레이의 표면 구조 및 형상, 이물질로 인한 돌기 측정 등 수 μm의 측정에 활용되며, 다층구조 측정의 박막 분리도 가능합니다.

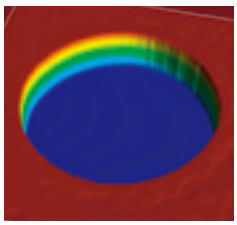
## 특징

- 대면적 가능한 고해상도 이미지 센서 (최대 33mm x 22mm)
- 빠른 스캔 속도 (MR: 200μm 기준 1초 이내)
- 우수한 Z 반복 정밀도 200nm
- 수 μm 높이의 표면 구조, 형상 bump 측정 가능
- 비축 광학계의 물리적 한계 해결 (Occlusion, Edge blur 없음)
- 투명 다층구조 박막 두께 측정 가능
- 검사 소프트웨어 탑재

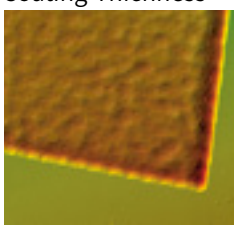
## 어플리케이션

- OLED Display 검사/측정
- 반도체 PCB Packaging 검사/측정
- 이차전지 표면 균일도 검사/측정
- 투명 도포액 두께 측정
- BGA 높이 측정
- Wire-bonding 기울기 형상화/측정

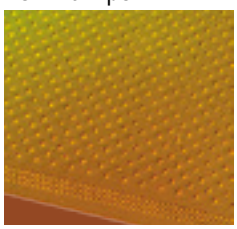
- Camera Hole



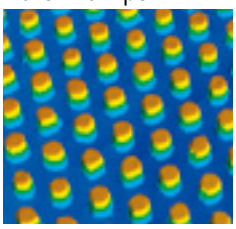
- Coating Thichness



- PCB Bumps



- Wafer Bumps



## 사양

| Model | nXI-2 | | |
|---|---|---|---|
| Type | S-type | M-type | L-type |
| FOV (mm) | 9 x 6 | 19 x 13 | 33 x 22 |
| Optical Resolution (μm) | 1.95 | 4.29 | 7.09 |
| Measuring Range (μm) | 250 | 250 | 600 |
| Z-repeatability [1] (μm) | 0.2 | | |
| Working Distance (mm) | 27 | 80 | 80 |
| DOF (μm) | 100 | 350 | 900 |
| Wavelength (nm) | 500 ~ 700 | | |
| Weight (kg) | <7 | <10 | <15 |
| Dimension (H x W x D) | 382 x 280 x 104 | 429 x 370 x 134 | 444 x 465 x 144 |
| Scan Type | Area 스캔 | | |
| Scan Time @MR 200μm | <1s @Z-step:840nm | | |
| Packing List | nXInterferometer, 조명 컨트롤러, 피에조 컨트롤러, PC | | |
| Interface | HW : CXP<br>SW : TCP/IP | | |
| Auto Focus [2] | Range : ±200μm<br>Time : <1s | | |

1) 10회 측정 시 3 Sigma / Standard sample / VC-C

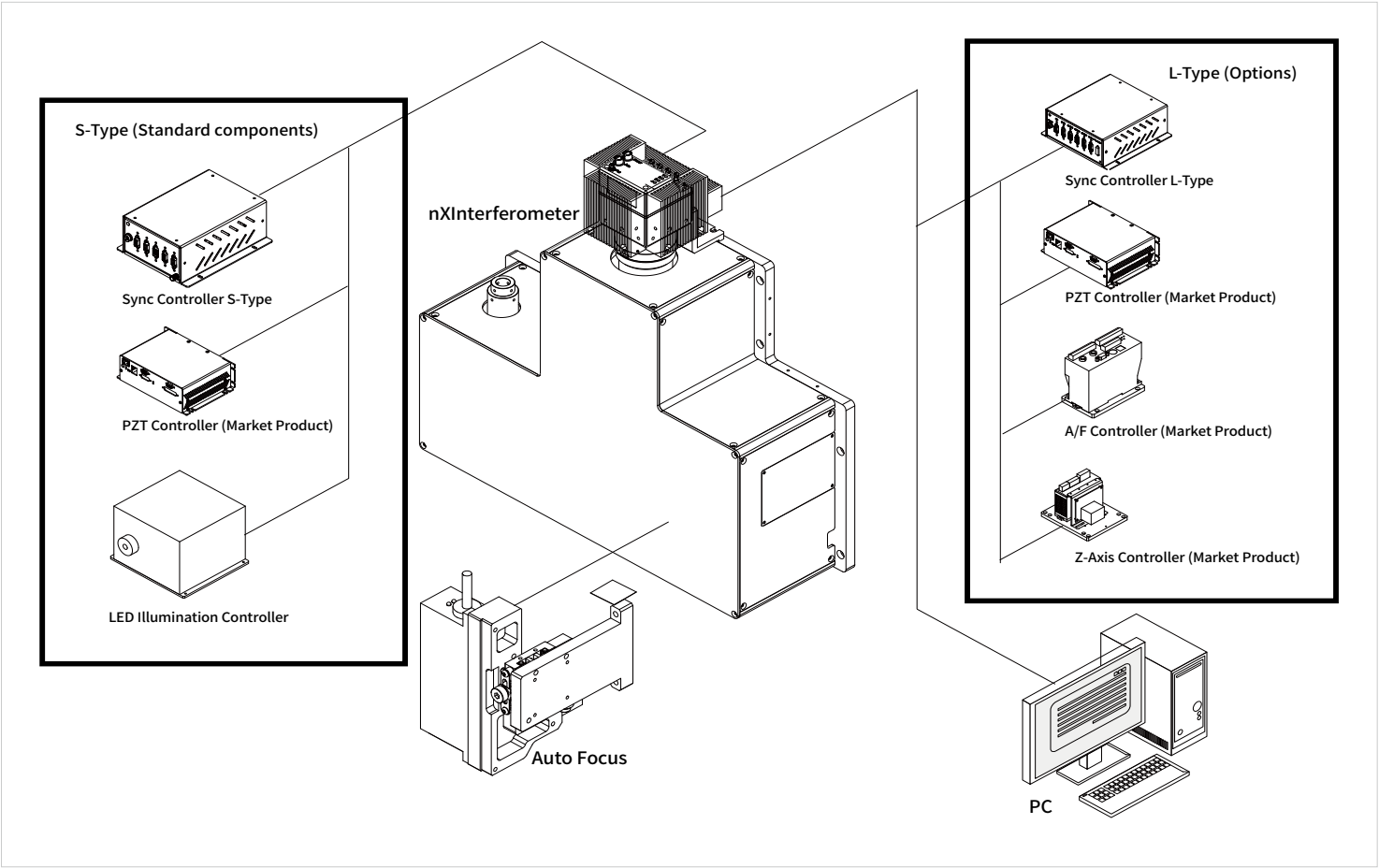
2) Options, A/F  사용 시 협의 필요

envision (08506) 서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 1동 603호 sales@envision.co.kr www.envision.co.kr 02-2624-5503

# 넥센서 nXI-2

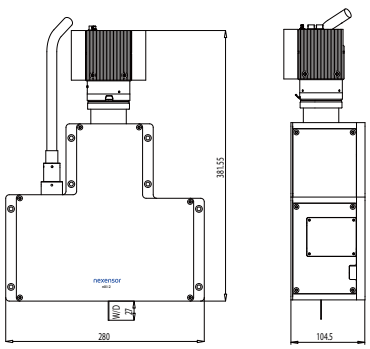
## 대면적 백색광 간섭 변위 측정 센서

## 제품 구성



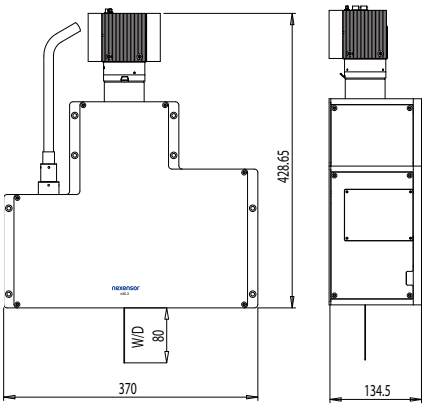

## 치수 및 도면

S-type



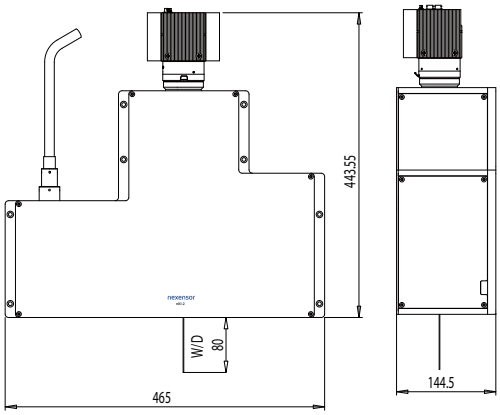

382 x 280 x 104

M-type




429 x 370 x 134

L-type




444 x 465 x 144

envision (08506) 서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 1동 603호 sales@envision.co.kr www.envision.co.kr 02-2624-5503